

液态金属打印电路灌封胶，高透明电子灌封胶

产品名称	液态金属打印电路灌封胶，高透明电子灌封胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-9315 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

液态金属打印灌封胶JR-9315说明书

一、产品特性及应用JR-9315是一种低粘度带粘性凝胶状透明双组分加成型有机硅灌封胶，可以室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点。

JR-9315在固化反应中不产生任何副产物，可以应用于液态金属打印电路板的灌封，适用于电子配件绝缘、防水及固定。完全符合欧盟ROHS指令要求。

二、典型用途

精密电子元器件

柔性液态金属打印电路板

透明度及复原要求较高的模块电源和线路板的灌封保护

三、使用工艺：

1.使用前，应把A（铂金催化剂胶体）和B（固化剂胶体）在各自的容器内充分搅拌均匀。避免长时间不使用导致的沉淀。

2.混合时，按照A组分：B组分 = 1：1的重量比严格称重，混合后充分搅拌均匀。

3.JR-9315可根据使用环境决定是否抽真空排泡，如需要，可把混合后搅拌均匀后的胶体放入真空容器中，在0.08MPa下脱泡5分钟，即可灌注使用。

4.室温保持在参数表中的温度之上，保持相应的固化时间，如果应用的产品较厚，固化时间会有所增加，室温或加温固化均可。硅胶的固化速度受环境温度影响很大，冬季气温低，固化需很长时间，建议采用加热方式固化，80~100℃下固化20分钟，室温条件下一般需8小时左右固化。

*注：以下物质可能会导致本产品中毒（不固化或者固化不完全），建议使用前取少量产品进行测试，必要时，使用天那水、洗洁精等清洗赶紧应用部位。

1) 不完全固化的缩合型硅酮

2) 胺(amine)固化型环氧树脂

3) 白蜡焊接处理(solder flux)

四、固化前后技术参数：

	性能指标	A组分	B组分
固 化	外观	透明流体	透明流体
	粘度（cps）	800 ± 100	600 ± 100
前 操 作	A组分：B组分（重量比）	1：1	

性

混合后黏度 (cps)

700-1000

能